证券代码:688172 证券简称:燕东微

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张劲松、主管会计工作负责人滕彦斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	308,997,801.95		-39.87
归属于上市公司股东的净利润	24,171,731.14		-72.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,797.37		-99.29
经营活动产生的现金流量净额	-46,528,531.28		-73.37
基本每股收益(元/股)	0.02		-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02		-71.43
加权平均净资产收益率(%)	0.17		减少 0.45 个百分点
研发投入合计	57,164,389.95		0.65
研发投入占营业收入的比例(%)	18.50		增加 7.45 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,134,489,835.33	18,484,430,578.71	-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	14,884,648,908.50	14,859,119,796.56	0.17

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,842,548.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,873,782.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-151,016.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,883.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,431,814.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,484,682.42	
合计	23,628,933.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税进项税加计抵减	1,319,420.64	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
个税手续费返还	332,410.79	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
递延收益摊销计入其他收益	5,192,831.99	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
合计	6,844,663.42	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-39.87	营业收入下降的主要原因是受市场环境下行影响,产品价格有所下滑,同时由于公司进行产品结构调整,导致产出有所降低
归属于上市公司股东的净利润	-72.87	归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是市场竞争加剧导致了部分产品价格下降,同时为了应对激烈市场竞争,加大了研发投入开发新品,使得当期量产产品产出减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99.29	同上
经营活动产生的现金流量净额	-73.37	经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是受市场环境下行影响,产品价格有所下滑,营业收入有所降低
基本每股收益(元/股)	-71.43	归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是市场竞争加剧导致了部分产品价格下降,同时为了应对激烈市场竞争,加大了研发投入开发新品,使得当期量产产品产出减少
稀释每股收益(元/股)	-71.43	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京电子控股有限责任公司	国有法人	420,573,126	35.07	420,573,126	420,573,126	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	168,912,889	14.09	55,898,466	55,898,466	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	113,014,423	9.42	0	0	无	0
北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	101,104,235	8.43	55,898,466	55,898,466	无	0
天津京东方创新投资有限公司	国有法人	93,164,110	7.77	93,164,110	93,164,110	无	0
盐城高新区投资集团有限公司	国有法人	45,205,769	3.77	45,205,769	45,205,769	无	0
北京电子城高科技集团股份有限公司	国有法人	22,602,884	1.88	22,602,884	22,602,884	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	21,930,194	1.83	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	17,074,784	1.42	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	14,228,987	1.19	0	0	无	0
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司-北京京国管股权投资基金(有限合伙)	其他	14,228,987	1.19	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	113,014,423	人民币普通股	113,014,423
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	113,014,423	人民币普通股	113,014,423
北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	45,205,769	人民币普通股	45,205,769
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	17,074,784	人民币普通股	17,074,784
产业投资基金有限责任公司	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司-北京京国管股权投资基金(有限合伙)	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
中国长城资产管理股份有限公司	12,613,783	人民币普通股	12,613,783
中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢 7 号员工参与战略配售集合资产管理计划	3,782,337	人民币普通股	3,782,337
香港中央结算有限公司	2,596,388	人民币普通股	2,596,388
张王斌	2,222,222	人民币普通股	2,222,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:北京燕东微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,124,142,888.60	5,315,564,882.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,279,178.08	2,002,809,315.07
衍生金融资产	-	
应收票据	440,345,172.74	514,930,995.00
应收账款	1,236,771,332.66	1,161,451,238.91
应收款项融资	61,826,039.84	38,522,297.42
预付款项	40,932,391.06	42,339,138.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,069,000.16	1,496,633.39
其中:应收利息		25,283,347.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	935,609,726.12	848,465,311.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,721,587.66	152,403,166.66
流动资产合计	9,201,697,316.92	10,077,982,979.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	101,388,888.88	100,756,944.44
其他债权投资	-	-
长期应收款		
长期股权投资	217,693,553.93	217,402,170.14
其他权益工具投资	1,083,448.95	1,178,400.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,279,438.51	110,201,890.51
固定资产	4,153,503,532.42	3,331,015,093.37
在建工程	3,661,472,647.25	3,917,234,613.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,685,641.16	1,867,087.46
无形资产	189,374,700.96	192,753,117.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	421,017.88	182,572.73
递延所得税资产	144,794,046.91	135,551,815.49
其他非流动资产	352,095,601.56	398,303,893.89
非流动资产合计	8,932,792,518.41	8,406,447,599.44
资产总计	18,134,489,835.33	18,484,430,578.71
流动负债:		
短期借款	61,451,156.11	42,483,130.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,598,842.88	165,052,251.61
应付账款	834,495,580.46	1,108,094,549.68
预收款项	-	385,312.99
合同负债	13,553,049.83	15,614,209.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,053,810.14	103,433,768.54
应交税费	12,264,914.03	26,731,612.79
其他应付款	36,932,265.83	37,023,838.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,594,836.71	147,507,072.97
其他流动负债	271,793,986.14	262,279,105.34
流动负债合计	1,654,738,442.13	1,908,604,852.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	801,802,500.00	890,802,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,507,057.53	1,013,927.36
长期应付款	522,688.80	522,313.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	585,915,657.64	609,460,328.40
递延所得税负债	62,942,001.90	66,593,573.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,452,689,905.87	1,568,392,642.25
负债合计	3,107,428,348.00	3,476,997,494.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,199,104,111.00	1,199,104,111.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,153,034,799.11	12,151,587,134.86
减:库存股		
其他综合收益	-79,331.01	10,952.44
专项储备		
盈余公积	18,142,964.25	18,142,964.25
一般风险准备		
未分配利润	1,514,446,365.15	1,490,274,634.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,884,648,908.50	14,859,119,796.56
少数股东权益	142,412,578.83	148,313,287.48
所有者权益(或股东权益)合计	15,027,061,487.33	15,007,433,084.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,134,489,835.33	18,484,430,578.71

公司负责人:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:杨洁

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:北京燕东微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	308,997,801.95	513,918,597.08
其中:营业收入	308,997,801.95	513,918,597.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,337,944.59	427,811,204.22
其中:营业成本	231,015,107.09	343,600,157.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,490,069.44	6,760,423.81
销售费用	9,149,635.26	8,415,463.75
管理费用	44,238,810.78	47,792,862.32
研发费用	57,164,389.95	56,797,907.94
财务费用	-19,720,067.93	-35,555,611.02
其中:利息费用	5,616,309.92	6,953,987.28
利息收入	27,255,793.79	43,561,433.74
加:其他收益	27,687,211.95	20,413,461.66
投资收益(损失以"-"号填列)	2,241,979.13	941,652.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-505,581.52	941,652.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,975,205.48	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,879,136.04	-6,309,061.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-13,149,203.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-14,181.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,685,117.88	87,990,059.89
加:营业外收入	41,885.25	87,456.28
减:营业外支出	1,061,769.10	7,428.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,665,234.03	88,070,088.06
减:所得税费用	-4,605,788.46	6,362,402.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,271,022.49	81,707,685.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,271,022.49	81,707,685.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,171,731.14	89,103,522.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,900,708.65	-7,395,837.25
六、其他综合收益的税后净额	-90,283.45	-109,515.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,283.45	-109,515.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-94,951.60	-74,236.52
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-94,951.60	-74,236.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,668.15	-35,278.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,668.15	-35,278.60
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,180,739.04	81,598,170.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,081,447.69	88,994,007.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,900,708.65	-7,395,837.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:杨洁

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:北京燕东微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,925,395.59	216,505,017.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	140,681,600.28	57,000,523.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,068,211.06	38,393,054.44
经营活动现金流入小计	421,675,206.93	311,898,594.89
购买商品、接受劳务支付的现金	274,971,270.70	182,330,443.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	147,296,063.12	112,784,749.39
支付的各项税费	29,722,166.22	18,730,094.31
支付其他与经营活动有关的现金	16,214,238.17	24,891,315.32
经营活动现金流出小计	468,203,738.21	338,736,602.06
经营活动产生的现金流量净额	-46,528,531.28	-26,838,007.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	37,147,691.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,709,907,972.60	-
投资活动现金流入小计	1,709,907,972.60	37,147,691.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,110,910.77	413,180,220.53
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	903,110,910.77	413,180,220.53
投资活动产生的现金流量净额	806,797,061.83	-376,032,529.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	18,946,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	18,946,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,433,701.86	6,654,980.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,055,555.56	20,156,918.73
筹资活动现金流出小计	16,489,257.42	26,811,899.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,456,742.58	-26,811,899.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,608.68	-25,887.95
五、现金及现金等价物净增加额	762,863,881.81	-429,708,323.77
加:期初现金及现金等价物余额	4,775,002,770.86	8,995,263,031.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,537,866,652.67	8,565,554,707.42

公司负责人:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:杨洁

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码:688172 公司简称:燕东微

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 四、风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),预计派发现金红利总额为 4,796.42 万元(含税),占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.6%,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	燕东微	688172	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	霍凤祥	赵昱琛
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 51 号	北京市北京经济技术开发区经海四路 51 号
电话	010-50973019	010-50973000-8543
电子信箱	bso@ydme.com	zhaoyc@ydme.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两大类。公司主要市场领域包括消费电子、电力电子、新能源和特种应用等。公司产品与方案板块的产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件。公司制造与服务板块聚焦于提供半导体开放式晶圆制造和封装测试服务。目前拥有一条 8 英寸晶圆生产线、一条 6 英寸晶圆生产线、一条 6 英寸 SiC 晶圆生产线和一条 12 英寸晶圆生产线。

截至 2023 年年底:

8 英寸晶圆生产线已实现量产的平台包括:700V BCD、0.18um CMOS、0.35um CMOS、Trench MOS、IGBT、FRD、TMBS、MEMS、SiN 硅光芯片等工艺平台,产能 5 万片/月;

6 英寸晶圆生产线已实现量产的平台包括:BJT、TVS、JFET、Planar MOS、IGBT、FRD、MEMS 工艺平台,产能 6.5 万片/月;

6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件的平台包括:1200V SiC SBD、1200V SiC MOS 工艺平台, 产能为 2000 片/月;

12 英寸晶圆生产线一阶段已实现试生产,已实现通线的工艺平台包括:高密度功率器件 TMBS 和 Trench MOS 产品;二阶段项目建设正在有序实施,规划产能 4 万片/月。

(二) 主要经营模式

公司产品与方案板块主要采用 IDM 经营模式,即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节,并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案,主要产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件;制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托,提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。

1.研发模式

公司制定了包括内控制度《产品研究与开发管理办法》和流程控制文件《设计和开发控制程序》等在内的研发管理制度,并根据实际执行情况持续完善更新,全面覆盖了研发的各个阶段。

针对产品与方案板块:

(1)可行性研究(立项)阶段

战略管理部门或市场部门根据行业内的技术产品发展趋势及对客户新产品需求的判断,提出新产品开发项目(以下简称"新品项目")的需求。公司组建跨职能小组对新产品的各种要求进行综合评估,如果达到公司立项条件,则根据相应的管理流程履行立项审批,同时指定该产品开发的项目负责人,进行后续的新产品开发项目。若该项目对公司未来发展有重要影响力,则纳入公司级科研项目计划,由公司项目管理办公室来稳步推进和协调项目的进度和交付。

(2)产品设计和样品试制阶段

新品项目立项后,项目负责人负责组建项目组(包括但不限于产品设计、生产组织、过程监控及可靠性验证以及客户验证等人员)并进行项目的任务分解,确定新产品开发计划以及关键里程碑节点。生产运营部门根据项目组要求制定样品试制计划并组织样品试制,待新品样品产出后,由质量部门协同设计人员制定并组织实施相应检验和可靠性验证方案,样品检验合格后,通知市场部门安排客户试用。新产品样品经客户认证通过后,通过跨职能项目小组评审后可转入试生产阶段。

(3)试生产阶段(小批量生产)

新产品进入试生产阶段后,由新品项目负责人协同相关部门编制小批量试生产计划,在试生产过程中,新品项目组负责组织收集小批量试生产过程中的各类技术和良率参数和成本参数等信息,待试生产完成后,组织会议评审试生产是否合格、能否转入下一阶段中批量或正式量产进行评审;若评审不通过,则重新安排新品小批量试制,若评审结论是中批量试产,则按照小批量过程管理执行;若评审结论是正式量产,则将该产品纳入公司的产品交付清单,按照正常的业务模式执行。

针对制造与服务板块:

(1)可行性研究(立项)阶段

制造与服务板块与产品与方案板块的立项阶段流程基本相同, 只是在实际开发过程中考虑的各种生产要素和交付物存在差异。

(2)新平台开发阶段

新品项目负责人根据项目目标任务,组建项目团队,制定项目开发计划,配置项目需求的各项资源,组织实施项目开发工作。以晶圆制造为例,新产品平台开发阶段的工作包括新平台设计规则的确定、Etest 测试图形设计、工艺流程和工艺规范设计、样品掩膜版的制作、新产品实验方案确认、单项工艺开发、新平台样品试制等,样品合格后提取器件模型,建立模型库及全套设计服务文件。

(3)新产品验证阶段

将新平台模型库及设计服务文件提交给客户用于客户产品设计, 产品导入后由产品技术部门进行新产品样品试制,新产品样品批工艺参数和器件参数合格后提交给设计公司进行功能验证。产品验证合格后,由产品技术部门进行新产品样品试制总结,经产品质量先期策划小组评审合格后转入试生产阶段。

(4)试生产阶段

新产品验证合格后,进入试生产阶段,由产品技术部门进行良率提升、工艺过程能力提升和产能提升。试生产各项指标达成后,由新产品开发项目负责人对试生产阶段的各项工作进行总结,经产品质量先期策划小组评审合格后转入量产阶段。

2.采购与生产模式

公司基于 ISO 体系标准并结合公司经营管理的需要, 建立了完善的内控管理体系和过程监督体系,制定了包括但不限于《生产运营管理办法》《产成品委外管理办法》《生产监控管理办法》《采购管理办法》《价格管理办法》《物资仓库管理办法》《供应商管理办法》《质量检验管理制度》《安全生产管理制度》《不合格品管理办法》以及配套的管理程序或实施细则等制度文件体系,有效管理生产运营过程中的各类风险。

(1)采购模式

①采购实施

采购实施过程主要严格按照公司《采购管理办法》及实施细则规定进行,采购方式会根据采购的物资对象采用不同的方式,其中生产用材料主要从公司的合格供应商名录中选取合格供应商,然后采购部门大多根据年度供应商评价结果与供应商签署年度采购框架协议, 公司根据生产需求并结合当期在途及在库等因素制定采购计划,采购部门依据采购计划执行采购,并通过采购订单的方式进行信息传递和过程约束。

②供应商管理

供应商管理严格按照《供应商管理办法》执行,包括但不限于供应商开发、供应商甄选、供应商评价以及合格供应商名录管理等内容。供应商甄选是其中的核心控制环节,尤其是生产用原材料的供应商有严格的供应商的导入认证程序和评价标准,合格后纳入合格供应商名录。供应商评价方面,原则上每年度供应商管理部门会组织相关部门针对供应商的技术水平、资质、价格、质量体系及物流管理等要素进行综合评价。其中生产用材料的核心制造供应商,还需要由质量管理部门组织相关人员进行现场审核,综合评价其综合交付能力,有利于有效保证产品质量及产能需求。

为了同时与供应商保持长期稳定的合作关系,保障公司稳定生产,公司不定期召开专题会议

讨论包括但不限于企业战略规划,企业生产经营状况和未来需求等内容。

③采购价格管理

采购价格管理主要参照公司《价格管理办法》和《采购管理办法》执行,时刻了解市场行情,对主要原材料价格变动制定相应的采购策略,争取最优价格。

④入库检验

入库检验环节严格按照《物资仓库管理办法》及相关制度执行。采购人员根据物资到货计划来协调仓库管理部门进行数量及外观清点,并进行收货。若该物资需要进行质检合格后入库,则还会由质量部门按照技术规范对原材料进行检验合格后方可入库,对于检验不合格的物料,公司会进行标识、单独分区域存放并按照不合格品管理规定进行处理。

(2)生产模式

①产品与方案板块

对于分立器件及模拟集成电路,公司以自身的全流程制造资源为基础,采用 IDM 模式经营,多年以来在消费电子、电力电子等领域公司积累了丰富的产品设计经验,产品在自有 6 英寸和 8 英寸晶圆生产线上进行生产,并委托外协封测厂利用公司自有产权设备进行封装测试。对于特种集成电路及器件,公司通过自有产线自行完成产品的封装和测试,依据相关严格标准进行加工,产出满足客户要求的产品。

公司市场部门根据市场及客户需求制定销售计划,生产运营部门根据销售计划、库存信息、设备产能、停机保养计划等制定生产计划,生产制造部门根据生产订单实际安排生产作业过程,以满足生产产出需要。

②制造与服务板块

公司采取"以销定产" 的生产模式。对于晶圆制造业务,生产运营管理部门会结合市场需求、物料供应、标准生产周期等因素制定生产计划,并组织相关部门评审。通过评审后,公司将主生产计划下达至生产制造部门。生产制造部门会根据该计划,分解生产作业计划安排,结合设备设施情况、物料到货计划以及人员配置等情况,合理安排保证按照计划和标准生产节奏进行产出。质量部门会对生产全过程的质量进行监督管理,并进行生产线关键工艺检验,并对完成加工制造的产品进行良率和外观等入库前检验或出厂前检查,确保入库产品为合格品。

对于封装测试业务,公司均采用委托外协封测厂进行封测的模式,公司不定期派出质量工程师对工厂质量控制情况进行稽核,协助提升产品品质。外协封测厂负责组织人员利用产线进行封装测试、日常设备维护等日常运营工作。公司市场部门在接到客户封装加工订单后,传递给产品运营部门,产品运营部门根据封装设备产能情况、材料准备情况,向外协封测厂下达委托加工订单,同时将客户的芯片发给外协封测厂。外协封测厂根据委托加工订单要求进行封装加工、测试、包装和入库,生产完成后按订单要求进行运输包装、出库并发货给客户。公司现有封测服务的封测技术均来源于公司自身。公司掌握了超小芯片高精度芯片粘片技术,可实现超小尺寸芯片(0.19*0.19mm)的高速粘片;掌握了超低线弧键合技术;掌握了超小 Pad 尺寸键合技术,可实现最小厚度 300μm 的超薄封装;掌握了高密度焊线、超长线弧、大转角线弧等焊线技术,可有效缩小管脚间距,进行多引脚封装;掌握了多芯片粘片技术、多层线弧控制技术,可实现多引脚集成电路封装。

3.销售模式

公司制定了《销售管理办法》《客户评价管理办法》《销售发票管理细则》,具体的规定和

流程如下:

(1)客户导入及其授信:市场部门收集即将发生业务的客户信息,包含但不限于公司营业执照、开票资料、其他商务信息等,并将信息录入内部系统,如客户是授信客户,通过内部流程审批后为客户分配信用额度和信用账期,审批通过后完成客户导入。

(2)报价:遵守市场原则,市场部门提交报价申请,审批后出具报价单发送给客户确认,双方达成一致后执行。

(3)接受订单与计划:市场部门将客户订单录入内部系统,包括规格型号、订单数量、价格、交货日期等,市场部门内部相关部门根据现有在制品或者库存情况确认可交付的日期并回复客户。市场部门根据客户的预测计划,形成滚动的市场需求计划,提交内部相关部门评审,生产部门按需求组织生产。

(4)发货:对于非授信客户,公司财务确认收到客户货款后进行发货;对于授信客户,在其授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

(5)销售对账及开票:市场部门定期与客户进行销售对账,双方确认后,市场部门在系统中生成发票,相关业务部门根据系统发票和市场部门提供的开票信息开具发票,市场部门审核后将发票寄送给客户。

(6)收款:对于非授信客户,公司在发货前收取货款;对于授信客户,市场部门按照相应的信用账期在发货后跟踪货款结算情况,以促进按期回款。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务,属于半导体行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于"制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业",行业代码"C39"。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品或服务属于"1 新一代信息技术产业--1.2 电子核心产业--1.2.4 集成电路制造";根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司主要产品或服务属于"1 新一代信息技术产业--1.3 电子核心产业--1.3.1 集成电路"。

集成电路作为全球信息产业的基础,诞生于 20 世纪五十年代的美国,经过七十多年的发展,已经成为全球信息技术创新的基石。根据世界半导体贸易统计组织统计和预测数据显示,全球集成电路市场规模呈周期性增长趋势。受益于 5G、物联网和人工智能等新技术的持续发展,集成电路应用领域逐渐扩大,从而拉动了全球集成电路产业的发展。半导体行业的重大发展以及 5G 技术带来的新应用也将带来更多发展的机遇,预计未来全球集成电路市场规模将继续扩大。

中国集成电路产业虽起步较晚,但凭借巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路行业增长的主要驱动力。近年来,随着 AIoT、新能源、汽车电子、通讯、超高清显示、特种应用等市场需求的不断提升,以及国家支持政策的不断提出,中国集成电路行业发展快速。

集成电路技术是一门应用广泛的电子学科,它是电子信息科学与技术的重要分支之一,主要涉及半导体器件结构、物理特性、工艺制程、设备、测试和封装等方面的知识,以及各种集成电路设计方法和应用。集成电路产业是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业,是当下信息技术产业的核心, 也是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路的应用已经渗透到国民经济的各个方面,不仅影响着国民经济的发展,而且也是当前国际竞争激烈以及全球资源流动和配置重点关注的产业。

纵观全球,半导体全球产业链已实现高度专业化,但在现有形势下,越来越多的国家将自主发展半导体产业上升到国家战略层面的高度。对于我国来说,半导体产业虽然目前面临技术和国际政治的双重挑战,但高速增长的国内市场规模为我国半导体产业结构升级优化提供了重要机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两类业务。公司产品与方案业务聚焦于设计、生产和销售分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件;制造与服务业务聚焦于提供半导体开放式晶圆制造与封装测试服务。

2023 年受客观市场环境变化影响,消费类电子产品市场需求疲软,价格不断下滑。公司不断加大新品研发,积极开发新产品及新工艺平台,由传统的消费类市场向新能源、工业、汽车等新领域转移,不断提升公司综合竞争力。

截至 2023 年底,产品与方案方面:

(1)在消费市场领域公司持续深耕,不断丰富产品系列,提升综合竞争力。公司的射频功率器件品种进一步丰富,应用领域逐步扩大,除通讯领域外,也在射频电源、射频加热、广播等领域获得客户认可,是国内射频功率器件的主要供应商之一,公司新推出的基于高可靠性设计且具有片上稳定性 RC 网络的系列射频 MOS, 可最大限度减少晶体管的退化和破坏, 能更好的应对负载失配严重的应用场景,满足广播等领域要求。

公司的双极阵列电路产品,具有输出电压高、输出电流大、输出漏电流小等特点,在白色家电中得到广泛应用。

公司的标准逻辑电路产品分别针对特种领域、工业领域及消费领域的不同特点,开发出 3 个系列上百款产品。通过定制化工艺进一步优化设计尺寸,提升产品竞争力。特别针对 HVCMOS 平台开发了数十款低边驱动电路,能够满足电力电子、工业等高压大电流应用需求。

(2)在特种集成电路及器件应用领域,拥有五十余年研发和产业化经验,是国内最早从事特种单片集成电路、混合集成电路、功率器件、光电器件研制的企业之一,具备较为完善的设计制造、封装测试、可靠性试验、失效分析和质量评价基础能力,拥有上百种门类,上千种规格型号的产品,以质量稳定、可靠性高等特点深得用户青睐,是国内重要的特种集成电路及器件供应商。近年来,基于国产装备的 8 英寸晶圆生产线,建立了 KFS 铝栅 CMOS 工艺平台,完成六十余款通用数字集成电路研制,建立了 KFS 硅栅 CMOS 工艺平台,完成百余款 54HC 系列产品研制。

截至 2023 年底,制造与服务方面:

8 英寸晶圆生产线已实现量产的平台包括:700V BCD、0.18um CMOS、0.35um CMOS、Trench MOS、IGBT、FRD、TMBS、MEMS、SiN 硅光芯片等工艺平台,产能 5 万片/月;

6 英寸晶圆生产线已实现量产的平台包括:BJT、TVS、JFET、Planar MOS、IGBT、FRD、MEMS 工艺平台,产能 6.5 万片/月,连续 3 年实现年产出超过 60 万片,良率保持 98%以上;

6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件的平台包括:1200V SiC SBD、1200V SiC MOS 工艺平台, 产能为 2000 片/月;

12 英寸晶圆生产线一阶段已实现高密度功率器件试生产,二阶段项目建设正在有序实施,规划产能 4 万片/月。

公司初步完成了晶圆生产线的产业布局,同时不断加大新工艺/新产品的研发,部分新工艺平台/新产品已通过国内头部车企的可靠性认证,制造与服务能力得到大幅提升,核心竞争力显著增强。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路广泛应用于 AIoT、新能源、汽车电子、通讯、超高清显示、特种应用等领域,在经济建设和人们的日常生活中发挥着重要的作用,是社会信息化、产业数字化的基石。随着社会的发展,集成电路在技术进步、成本降低、功耗优化、便携性和紧凑设计、可靠性和稳定性等方面越来越具有重要的意义,将更广泛应用于 AI 和机器学习、云计算和大数据、物联网(IoT)、自动驾驶和智能交通、生物医学应用等领域,将对人们的生活、工作和社会产生深远的影响。

随着信息技术的飞速发展,对于数据传输速率的要求越来越高,硅光为需要高容量、高速率的应用提供了一个新的平台。

硅光即硅基光电子,指在硅和硅基衬底材料上,利用硅 CMOS 工艺对光电子器件进行开发和集成的一种新技术。由于其既拥有微电子的工艺成熟、集成度高、价格低廉等基础,又兼具光电子的极高带宽、超快速率、抗干扰性、低功耗等优势,在微电子技术接近瓶颈的后摩尔定律时代,受到诸如英特尔、华为等龙头企业热捧,技术不断进步,产业化进程日益加快,俨然已经成为半导体领域竞争的另一条赛道。

为了追求更高的通信速率、更高的能量利用效率,硅基光电子器件一直在追求高带宽的电光调制器、更低的耦合损耗与传输损耗。高带宽的电光调制器能够满足高速通信的需求,实现更快速、更稳定的数据传输,带来更高的能量利用效率,逐渐走进大众的视野;与此同时,更低的耦合损耗与传输损耗也是硅光技术长久攻关的方向,更低的传输损耗意味着光信号在光纤中传输时,能量衰减更慢,从而可以实现更长的传输距离,较低的损耗意味着系统可以支持更高的光功率,从而增加系统的带宽,使用更少的能源来实现相同的通信效果,从而降低成本。这也是当前硅基光电子领域的重要研究方向,尤其为下一代高速率光模块做准备,例如在超大数据中心,超算力系统在人工智能方面的应用,其主要应用领域包括数据中心(英特尔在此领域占据主导地位)、电信(如 Acacia 公司)以及光学激光雷达系统。

根据 Yole 报告数据,2022 年硅光子市场价值为 6800 万美元, 预计到 2028 年将以 44%的复合年增长率增长至 6 亿美元以上(CAGR2022-2028)。

随着数据中心的快速发展,预计未来十年内,特别是在人工智能(AI)和机器学习(ML)领域,高速计算的需求将迅速增长。目前,基于 3nm 技术的最先进芯片正在逼近其物理极限,同时数据传输需求也在急剧增加。在这一背景下,硅光因其促进高速通信的能力而备受关注。博通公司的战略计划揭示了切换芯片的发展轨迹,预计将从 51.2Tb/s(5nm 工艺节点)增长到 2025 年的 102.4Tb/s(3nm 工艺节点),再到 2027 年达到 204.8Tb/s(2nm 工艺节点)。这种指数级增长为硅光在网络应用中的进步提供了重要动力,为未来数据容量的显著提升奠定了基础。因此,高速率光模块的需求日益显著,进而更高带宽、更高速率的电光调制器,更低的波导传输损耗,更低的耦合损耗至关重要。

数据中心硅光芯片发展趋势 图片来源于 Yole

在数据中心内部通信中,服务器、存储设备、网络设备等之间需要进行大量的数据传输。硅光芯片以其高速、低功耗、高集成度等优势,成为实现数据中心内部通信的理想选择。随着数据中心规模的不断扩大和数据传输速率的不断提升,硅光芯片在数据中心内部通信市场的需求量将持续增长。

数据中心互联中,随着云计算、大数据等应用的普及,数据中心之间的数据传输量呈爆发式增长。硅光芯片以其高速、高可靠性、低功耗等特点,成为实现数据中心互联的关键技术。随着数据中心互联需求的不断增长,硅光芯片在领域的应用前景十分看好。

长距离光通信中,硅光芯片具有优秀的光学性能,能够实现长距离、高速、低延迟的光通信。这使得硅光芯片在跨城市、跨国界的数据中心互联中具有广阔的应用前景。随着全球数据中心的布局和互联需求的增加,硅光芯片在长距离光通信市场的需求量将不断增长。

根据 Yole 公司统计的 2022 年硅光模块市场数据, 硅光模块在数据中心及通信领域整体达 17.1 亿美元,国外英特尔与思科公司占据了绝大部分市场份额,国内公司所占有的市场份额较小。

2022 年硅光模块市场份额统计(Yole) 图片来源于 Yole

综上所述, 硅光芯片在 DC 和 DCI 领域具有广阔的市场应用前景。随着数据中心规模的不断扩大、数据传输速率的不断提升以及 5G 等新一代信息技术的快速发展,硅光芯片的需求量将持续增长。同时,随着技术的不断进步和成本降低,硅光芯片在市场上的竞争力也将不断增强。因此,硅光芯片产业将迎来巨大的发展机遇。

从国内外发展情况可以看出,国内外均在向更高带宽、更低损耗的技术方案发展,其发展趋势可以从以下几个方面来看:

(1)集成化与微型化:随着硅基光子集成技术的发展,电光调制器正逐步实现与其他硅光子器件(如光波导、光探测器等)的高度集成。这种集成化不仅可以减小系统体积,提高稳定性,还可以降低能耗和成本。此外,微型化技术也在不断发展,使得硅基电光调制器尺寸越来越小,更加适应大规模集成和高速传输的需求。

(2)性能优化:硅基电光调制器在性能上也在不断优化。这包括提高调制速率、降低调制电压、减小传输损耗、提高信噪比等。通过改进材料、优化结构、提高制造工艺等方式,可以不断提升硅基电光调制器的性能,以满足更高速、更稳定的光通信需求。

(3)新材料与新结构:随着材料科学的发展,硅基平台上的电光调制器也在不断探索使用新材料和新结构。例如,使用高电光系数的材料可以增强调制效果,使用新型波导结构可以提高光场限制和传输效率等。这些新材料和新结构的引入将有助于进一步提升硅基电光调制器的性能。

基于硅光未来发展趋势,公司基于国产装备将持续打造兼容 CMOS 工艺,具有自主知识产权的硅光工艺平台,并形成一套适用于客户设计硅光芯片的 PDK ,服务于国内众多的硅光设计企业和科研院所。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	18,484,430,578.71	17,824,653,931.58	3.70	13,072,659,260.91
归属于上市公司股东的净资产	14,859,119,796.56	14,348,604,152.99	3.56	10,129,796,126.78
营业收入	2,126,903,653.81	2,175,224,334.82	-2.22	2,034,699,554.29
归属于上市公司股东的净利润	452,292,466.72	462,125,789.66	-2.13	550,444,957.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,503,381.80	364,522,471.61	-20.03	385,384,252.72
经营活动产生的现金流量净额	402,768,425.36	796,394,617.50	-49.43	441,608,214.31
加权平均净资产收益率(%)	3.10	4.46	减少 1.36 个百分点	8.49
基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56	0.78
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 5.96 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	513,918,597.08	570,010,672.32	440,143,955.12	602,830,429.29
归属于上市公司股东的净利润	89,103,522.74	178,424,759.10	80,380,188.46	104,383,996.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,400,250.65	132,224,677.56	24,450,732.75	58,427,720.84
经营活动产生的现金流量净额	-26,838,007.17	199,384,853.01	-41,537,156.11	271,758,735.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,097
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京电子控股有限责任公司	0	420,573,126	35.07	420,573,126		无	0	国有法人
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	168,912,889	14.09	55,898,466		无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	113,014,423	9.42	0		无	0	国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	101,104,235	8.43	55,898,466		无	0	其他
天津京东方创新投资有限公司	0	93,164,110	7.77	93,164,110		无	0	国有法人
盐城高新区投资集团有限公司	0	45,205,769	3.77	45,205,769		无	0	国有法人
北京电子城高科技集团股份有限公司	0	22,602,884	1.88	22,602,884		无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	21,930,194	1.83	0		无	0	国有法人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	17,074,784	1.42	0		无	0	国有法人
产业投资基金有限责任公司	0	14,228,987	1.19	0		无	0	国有法人
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司-北京京国管股权投资基金(有限合伙)	0	14,228,987	1.19	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

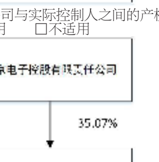
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

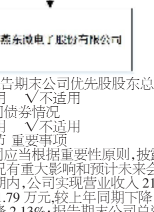
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 212,690.37 万元,较上年同期下降 2.22%;实现利润总额

45,551.79 万元,较上年同期下降 13.65%;实现归属于母公司所有者的净利润 45,229.25 万元,较上年同期下降 2.13%;报告期末公司总资产 1,848,443.06 万元,较期初增长 3.70%;归属于母公司所有者权益为 1,485,911.98 万元,较期初增长 3.56%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-009

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"燕东微")第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2023 年度总经理工作报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度董事会工作报告,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2023 年度财务决算报告,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2024 年度财务预算报告,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2023 年度报告全文及其摘要,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司关于募集资金存放与使用情况专项报告,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

同意公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明,并提交公司股东大会审议。

关联董事张劲松、朱保成回避表决。

表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用自有资金进行现金管理。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度,并提交公司股东大会审议。

关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案》

同意公司 2024 年新增对外担保预计额度,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2023 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司 2023 年度独立董事述职报告,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十五)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十六)审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

同意公司 2023 年度社会责任报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十七)审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意公司聘任 2024 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十八)审议通过《关于 2024 年提质增效重回报行动方案的议案》

同意公司 2024 年提质增效重回报行动方案。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十九)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十一)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十二)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十三)审议通过《关于调整北京光电融合产业投资基金(有限合伙)出资额度的议案》

同意公司调整北京光电融合产业投资基金(有限合伙)出资额度。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十四)审议通过《关于 2024 年度新增借款额度的议案》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十五)审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年度股东大会。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-010

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"燕东微")第二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度监事会工作报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2023 年度报告全文及其摘要。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

同意公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

关联监事王爱清回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)审议通过《关于审议公司自有资金进行现金管理的议案》

同意公司自有资金进行现金管理。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度。

关联监事王爱清、元巍回避表决。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案》

同意公司 2024 年新增对外担保预计额度。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

同意公司 2023 年度社会责任报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十四)审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意公司聘任 2024 年度审计机构。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十五)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十六)审议通过《关于 2024 年度新增借款额度的议案》

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日